证券代码:688416　　证券简称:恒烁股份　　公告编号:2024-076

恒烁半导体(合肥)股份有限公司 关于部分募投项目变更及延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 拟变更的募投项目基本情况:恒烁半导体(合肥)股份有限公司(以下简称"恒烁股份"、"公司")拟将募投项目"NOR闪存芯片升级研发及产业化项目"变更为"闪存芯片升级研发及产业化项目"、"通用MCU芯片升级研发及产业化项目"变更为"MCU芯片升级研发及产业化项目"、"CiNOR 存算一体AI推理芯片研发项目"变更为"面向端侧AI的低功耗软硬件推理系统研发项目"。上述项目的投资总额、募集资金拟投入金额、实施主体及实施地点均不涉及变更。

● 拟延期募投项目:变更后的募投项目"闪存芯片升级研发及产业化项目"、"MCU芯片升级研发及产业化项目"及"面向端侧AI的低功耗软硬件推理系统研发项目"根据实际建设进度及要求,将项目达到预定可使用状态日期分别延期至2027年7月、2028年1月及2028年1月。

● 审议情况:公司于2024年12月27日召开公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》,同意公司根据研发战略规划和实际发展情况对部分募投项目进行变更及延期,该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意恒烁半导体(合肥)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1255号)同意注册,公司首次向社会公众发行人民币普通股2,066.00万股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币65.11元/股,募集资金总额为人民币1,345,172,600.00元,扣除发行费用人民币135,532,200.00元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币1,209,640,400.00元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2022年8月24日出具了(容诚验字 [2022]230Z0228号)验资报告。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司已与保荐机构及募集资金专户开户银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《恒烁半导体(合肥)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额
1	NOR闪存芯片升级研发及产业化项目	20,318.00	20,318.00
2	通用MCU芯片升级研发及产业化项目	17,731.00	17,731.00
3	CiNOR存算一体AI推理芯片研发项目	12,339.00	12,339.00
4	发展与科技储备项目	25,000.00	25,000.00
合计		75,388.00	75,388.00

截至2024年6月30日,公司募集资金投资项目及募集资金使用情况具体详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、本次募投项目延期以及变更调整的具体情况及原因

(一)本次拟延期及变更的募集资金投资项目的具体情况

原项目计划投资和实际投资情况(截至2024年11月30日)如下:

单位:人民币万元

承诺投资项目投向	募集资金承诺投资总额	截至2024年11月30日承诺投入金额	截至2024年11月30日累计投入金额	截至2024年11月30日投入进度	项目达到预定可使用状态日期
NOR闪存芯片升级研发及产业化项目	20,318.00	20,318.00	7,786.97	38.33%	2025年1月
通用MCU 芯片升级研发及产业化项目	17,731.00	17,731.00	3,549.48	20.02%	2025年1月
CiNOR 存算一体AI推理芯片研发项目	12,339.00	12,339.00	2,165.30	17.55%	2025年1月

根据公司发展战略与实际情况,公司拟变更原有募集资金项目并对变更后的募集资金项目进行延期,具体调整如下:

单位:人民币万元

本次募集资金变更前				本次募集资金变更后			
项目名称	投资总额	募集资拟投入金额	项目达到预定可使用状态日期	项目名称	投资总额	募集资金拟投入金额	项目达到预定可使用状态日期
NOR闪存芯片升级研发及产业化项目	20,318.00	20,318.00	2025年1月	闪存芯片升级研发及产业化项目	20,318.00	20,318.00	2027年7月
通用MCU芯片升级研发及产业化项目	17,731.00	17,731.00	2025年1月	MCU芯片升级研发及产业化项目	17,731.00	17,731.00	2028年1月
CiNOR 存算一体AI推理芯片研发项目	12,339.00	12,339.00	2025年1月	面向端侧AI的低功耗软硬件推理系统研发项目	12,339.00	12,339.00	2028年1月

以上募集资金项目延期及变更不涉及投资总额、募集资金拟投入金额、实施主体及实施地点的变更。

(二)本次募投项目延期及变更的具体原因

(1)NOR闪存芯片升级研发及产业化项目

NOR 闪存芯片升级研发及产业化项目是基于当时的市场环境和公司战略制定的,着力研发基于下一代50nm和40nm技术工艺制程,容量覆盖256Mb～1Gb,具有高可靠性和高稳定性的NOR Flash存储芯片,旨在加强我们在非易失性存储器市场的业务布局,并巩固公司的市场地位。然而,随着行业技术的快速发展和市场环境的变化,由于该投资项目所指定的行业技术限定的范围较狭窄,影响了募集资金使用效率,增加了项目投资实现预期效益的不确定性风险,为确保资金的有效利用和项目预期效益的实现,公司认为有必要在原有项目的基础上进行变更。

原投资计划专注于50nm & 40nm ETOX工艺节点项目的研发,但随着参与NOR闪存开发的主流晶圆厂的增加,工艺节点也相对更丰富,除了已有的50nm和开发中的40nm以外,包括不限于5xnm和4xnm及其他先进工艺节点,公司在多个工艺节点上进行研发,有助于进一步平衡产能,完善产品线,巩固市场地位。

ETOX存储单元结构虽然具备制程相对稳定等优势,但随着国内晶圆厂的技术发展,一些新的存储单元结构也在逐渐兴起,部分工艺节点存储单元面积和制造成本相较于现有工艺具有差异化优势。

根据公司对相关市场和技术的调研,"闪存芯片升级研发及产业化项目"具有广阔的研发和市场前景。公司已将全部核心技术应用于现有产品,并将持续发挥研发能力和技术积累优势,实现科技成果与产业发展的深度融合。本项目将使公司在巩固存储芯片领域市场地位的同时,向更高端的技术领域拓展。依托公司在NOR闪存领域的技术积累及客户资源优势,为此项目的顺利研发及后续推广提供了有力保障。根据上述研发项目调整计划,考虑到该项目的研发费用(包括不限于研发人员薪酬、流片费用、测试费用等)投入比例较高,公司拟调整本项目的内部具体投资结构,具体调整情况如下:

单位:人民币万元

序号	投资具体内容	调整前项目投资总额	调整后项目投资总额	增减情况
1	设备及软件等购置费用	4,389.00	2,031.80	-2,357.20
2	研发费用(研发人员薪酬、产品试制、流片及测试费用等)	11,019.70	13,376.90	2,357.20
3	铺底流动资金	4,909.30	4,909.30	0.00
合计		20,318.00	20,318.00	0.00

(2)通用MCU 芯片升级研发及产业化项目

通用MCU芯片升级研发及产业化项目是基于公司M0+内核的32位MCU产品,进一步研发通用M3和M4系列MCU产品,然而基于对市场环境和竞争格局的判断以及公司现有的研发市场积累,决定继续完善消费类MCU的产品布局以增加产品竞争力和市场份额,同时基于电驱,电控,储能等巨大的市场机会以及国产替代需要的考量,公司将进一步研发马达控制,工业控制等领域的32位高性能MCU,新的应用领域所选择的CPU内核不局限于M3和M4内核。根据上述研发项目调整计划,考虑到该项目的研发费用(包括不限于研发人员薪酬、流片费用、测试费用等)投入比例较高,公司拟调整本项目的内部具体投资结构,具体调整情况如下:

单位:人民币万元

序号	投资具体内容	调整前项目投资总额	调整后项目投资总额	增减情况
1	设备及软件等购置费用	5,603.00	2,659.65	-2,943.35
2	研发费用(研发人员薪酬、产品试验、流片及测试费用等)	7,556.40	10,499.75	2,943.35
3	铺底流动资金	4,571.60	4,571.60	0.00
合计		17,731.00	17,731.00	0.00

(3)CiNOR 存算一体AI推理芯片研发项目

本项目系基于此前消费市场环境、端侧智能物联网发展趋势以及公司未来发展战略等因素制定,总体尚处于端侧存算一体芯片的探索阶段,计划达产后将推动公司成功切入智能物联网市场,因此智能物联网市场情况以及端侧存算一体芯片发展情况对于公司原项目的资金投入和研发推进有重大影响。近年来,由于该投资项目所面临的市场环境以及技术格局发生了较大变化:随着TinyML赋能低成本MCU完成AI任务市场对于存算一体芯片的性能预期进一步提高;生成式大模型的爆发为存算一体芯片提出了新的要求,面向大模型的复杂任务,单一的存储介质已无法独立满足现有算法的全部计算需求,需要多种介质相互融合、共同协调,提高了芯片设计的复杂度。此外下游产品市场竞争态势和软硬件技术发展情况尚有较大的完善空间,综上因素对公司产品推进节奏产生一定影响。根据上述研发项目调整计划,考虑到该项目的研发费用(包括不限于研发人员薪酬、流片费用、测试费用等)投入比例较高,公司拟调整本项目的内部具体投资结构,具体调整情况如下:

单位:人民币万元

序号	投资具体内容	调整前项目投资总额	调整后项目投资总额	增减情况
1	设备及软件等购置费用	5,024.00	1,233.90	-3,790.10
2	研发费用(研发人员薪酬、产品试制、流片及测试费用等)	7,315.00	11,105.10	3,790.10
合计		12,339.00	12,339.00	0.00

综上,基于谨慎原则和合理利用募集资金原则,为降低项目收益的不确定风险,公司经审慎评估决定对原有募集资金项目进行变更,以适应公司的研发战略规划,提高募集资金的使用效率。

四、新募投项目的具体内容

(1)闪存芯片升级研发及产业化项目

本项目将围绕灵活容量、低功耗和高可靠性这一产品定位,采用业界领先的闪存工艺路线,着力研发基于最新工艺制程节点,容量覆盖市场主流需求范围,具有高可靠性和高稳定性的存储芯片。本项目具体研发的产品包括:基于5xnm及以下ETOX技术节点的NOR 闪存系列存储芯片;New Generation NOR等其他先进技术闪存系列存储芯片。基于本项目的产品将被应用于蓝牙、物联网、智能穿戴设备、智能家居、智能手机等领域。

(2)MCU 芯片升级研发及产业化项目

本项目基于公司现有ARM内核的32位MCU产品,进一步研发基于ARM内核以及RISC-V内核的MCU系列产品。产品应用涵盖消费、工业控制、汽车电子等领域,如智能可穿戴设备、TWS耳机、智能电表、各类传感器、充电控制、照明、马达控制、汽车电子和人工智能等领域。

(3)面向端侧AI的低功耗软硬件推理系统研发项目

本项目将以存算一体技术为核心,围绕低功耗和端侧AI的性能需求,研发出一套兼顾AI性能和存算一体低功耗的端侧AI推理系统。包括但不限于:适合端侧AI场景的算法模型及其相关软件IP、超低功耗的存算一体芯片及其相关低功耗IP、融合前述二者软硬件性能的开发平台及其解决方案、以及兼具端侧AI低功耗和云端大模型高性能优势的离在线交互方案。本项目依托公司在存算一体领域的技术积累以及在消费电子领域的客户资源优势,立足解决端侧AI由于自身计算密集、存储密集特性带来的带宽以及功耗的痛点,为更多的端侧设备提供AI能力;本项目的低功耗优势,能够充分解决功耗敏感设备的AI痛点,也更顺应国家绿色经济和可持续发展的政策导向,促进经济的高质量发展。本项目希望让万物皆可AI,以此拓宽AIoT的端侧市场,完善并丰富公司产品布局,稳步推进公司业务的持续发展,综合提升公司在AIoT市场的综合竞争力。

五、变更部分募投项目的可行性分析

(1)闪存芯片升级研发及产业化项目

公司目前的NOR Flash产品在无线、蓝牙设备、智能穿戴设备、IPC等市场展现出竞争优势。为了确保公司的长期发展和扩大业绩增长空间,减少单一下游市场波动对公司业绩的影响,公司需要不断进行技术革新和产品线的扩展。一方面,要对现有产品线进行更新换代,以更优势的成本和性能来巩固和提升公司在这些应用领域的市场地位;另一方面,要将闪存芯片产品的应用范围扩展到PC、工业控制、物联网、5G基站等更高价值的市场领域。本项目对于完善公司在非易失性存储器芯片市场的布局具有重大作用,是公司扩大产业规模的重要举措。

(2)MCU 芯片升级研发及产业化项目

公司现有消费类MCU产品面临市场的激烈竞争,结合公司研发人员现状,公司将进一步扩展MCU目标市场,从而提升公司在MCU上的竞争力。

市场需求方面:就通用类MCU而言,未来趋势朝着成本优化、性能增强、可靠性更高、各种通信接口更多的方向发展,新品的推出有利于拓展市场需求,提前布局新的MCU,从而提高市场占有率,增加销售额;专用MCU而言,电机控制类MCU因电机技术的发展、成本下降以及应用场景的增加,未来呈增长趋势,公司因通用MCU耕耘多年,客户基础雄厚,增加该系列产品可以带来新的增量。

(3)面向端侧AI的低功耗软硬件推理系统研发项目

端侧低功耗的人工智能产品具有广阔的市场空间,产品应用范围广泛,包括但不限于智能手机、智能手表、智能玩具、智能安防、PC以及汽车等设备。相较于云端AI,端侧AI在终端设备上直接运行和处理人工智能算法,数据、计算均在本地,具有隐私保护性强的特点,同时可靠性高、综合成本低廉。据公开资料显示,2023年中国端侧AI行业市场规模约为1,939亿元。目前端侧AI使用的多为传统架构,例如MCU、GPU和NPU等,主要解决AI的有无问题,自身能耗较高,一定程度上限制了端侧AI在功耗敏感场景的应用,尤以可穿戴设备为甚。随着低功耗产品的出现,将会有更多的端侧设备具备AI的能力。

本项目融合了先进的人工智能算法和存算一体技术,同时深度结合现有市场需要,能够解决不同场景下的行业痛点,提供从算法到芯片的完整解决方案。同时,公司在人工智能算法、存算一体技术上有多年的技术积累,对于智能物联网市场也有深入的理解,能够针对现有的智能玩具、智能家居、端侧大语言模型等应用,提供创新的超低功耗推理方案,兼顾AI的高性能表现以及超低功耗要求。

公司拥有一支高素质的设计研发人才队伍,实际控制人深耕集成电路行业多年,具有丰富的芯片设计和市场销售经验。研发人员均具有丰富的芯片产品设计经验。经过数年的自主研发积累,公司在闪存芯片、MCU芯片的工艺制程、良率提升、核心算法、存算一体研发方面积累了一批核心技术。公司优秀的研发团队和长期的技术积累为本项目顺利实施提供了有力的人才和技术保障。公司在产业链上下游与客户、供应商建立的良好合作关系,为本项目的顺利实施提供了健全的产业化保障。

六、 新项目尚需有关部门审批情况

公司将在项目推进过程中根据项目进度按照相关法律法规的要求办理相关审批手续。

七、本次变更及延期募投项目的风险

公司本次变更及延期部分募集资金投资项目的决定是基于当前行业前景、市场需求以及公司目前经营现状、战略规划等因素作出的。变更后募集资金投资项目在后续的实施过程中,面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理、技术研发等方面不确定因素的影响,存在宏观经济环境及行业政策变化、市场需求变动、项目无法顺利推进等风险。

八、本次变更及延期募集资金投资项目对公司的影响

公司本次变更及延期部分募集资金项目事项是公司基于募集资金投资项目实际进展情况以及公司经营发展规划进行的必要调整,符合公司发展战略,有利于研发项目的推进落地,有助于提高募集资金使用效率,进一步提升公司研发创新的综合实力,为公司开拓更多市场奠定坚实的基础。

九、本次变更及延期募投项目后的募集资金管理

因本次变更前后募集资金项目的投资总额未发生变更,为规范公司募集资金管理,变更后项目仍使用原募集资金专户,公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求,规范使用募集资金。

十、专项意见说明

(一)监事会意见

公司本次变更及延期部分募集资金投资项目,综合考虑了原募集资金投资项目以及公司的实际情况,变更及延期后的募集资金投资项目符合公司发展规划及实际需要,有助于提高募集资金使用效率,进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力,符合公司和全体股东的利益,因此,监事会同意公司本次变更及延期部分募集资金投资项目事项。

(二)保荐机构专项核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次变更及延期部分募集资金投资项目事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的内部审批程序,尚需提交公司股东大会审议,符合相关法律法规等规定,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司本次变更及延期部分募集资金投资项目事项无异议。

特此公告。

恒烁半导体(合肥)股份有限公司董事会
2024年12月28日

证券代码:688416　　证券简称:恒烁股份　　公告编号:2024-077

恒烁半导体(合肥)股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

恒烁半导体(合肥)股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第六次会议于2024年12月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年12月24日以通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席陈梅女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(1)审议通过《关于部分募投项目变更及延期的议案》

公司本次变更及延期部分募集资金投资项目,综合考虑了原募集资金投资项目以及公司的实际情况,变更及延期后的募集资金投资项目符合公司发展规划及实际需要,有助于提高募集资金使用效率,进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力,符合公司和全体股东的利益,因此,监事会同意公司本次变更及延期部分募集资金投资项目事项。

经表决,3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

特此公告。

恒烁半导体(合肥)股份有限公司监事会
2024年12月28日

证券代码:688416　　证券简称:恒烁股份　　公告编号:2024-078

恒烁半导体(合肥)股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年1月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年1月13日　14点 30分

召开地点:恒烁半导体(合肥)股份有限公司(合肥市庐阳区天水路与太和路交口西北庐阳中科大校友企业创新园11号楼)会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年1月13日

至2025年1月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于部分募投项目变更及延期的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审议通过。相关公告已于2024年12月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》予以披露。公司将于2025年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年第一次临时股东大会会议材料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688416	恒烁股份	2025/1/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)现场出席会议的预约登记

拟现场出席本次股东大会会议的股东及股东授权代理人请于2025年1月12日17:00之前将登记文件扫描件(详见登记手续所需文件)发送至公司邮箱(Zbitsemi@zbitsemi.com)进行预约登记,并在邮件中注明"恒烁股份-2025年第一次临时股东大会"字样。为避免信息登记错误,公司不接受电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时需出示相关证件原件以供查验。

(二)登记手续

1、自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件等持股证明。

2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明。

3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件等持股证明。

4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照副本复印件并加盖公章、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件等持股证明。

(三)注意事项

1、个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人/执行事务合伙人证明文件复印件需加盖公司公章。

2、参会人员须于会议预定开始时间之前办理完成参会登记手续,公司将于2025年1月13日13:00至14:00为参会人员在公司董事会办公室办理现场登记手续。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式:

通信地址:合肥市庐阳区天水路与太和路交口西北庐阳中科大校友企业创新园11号楼

联系电话:0551-65673252

传真:0551-65673252

Email:Zbitsemi@zbitsemi.com

联系人:周晓芳、肖倩倩

特此公告。

恒烁半导体(合肥)股份有限公司董事会
2024年12月28日

附件1:授权委托书

授权委托书

恒烁半导体(合肥)股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年1月13日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于部分募投项目变更及延期的议案》			

委托人签名(盖章):　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688416　　证券简称:恒烁股份　　公告编号:2024-079

恒烁半导体(合肥)股份有限公司 股东减持计划完成暨减持结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,恒烁半导体(合肥)股份有限公司(以下简称"恒烁股份或"公司")股东宁波梅山保税港区天鹰合胜创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"天鹰合胜")持有公司股份3,787,854股,占公司总股本的4.58%。以上股份均来源于公司首次公开发行前取得的股份,天鹰合胜的股份于2023年11月20日起上市流通。

● 减持计划的实施结果情况

公司于 2024 年11月1日披露了《股东减持股份计划公告》(公告编号:2024-067),宁波梅山保税港区天鹰合胜创业投资合伙企业(有限合伙)计划通过集中竞价方式减持合计不超过公司股份总数的0.89%(即738,127股)。

公司于 2024 年12月27日收到公司股东天鹰合胜出具的《减持计划完成暨减持结果告知函》,截至2024年12月26日,天鹰合胜通过集中竞价方式累计减持公司股份738,127股,占公司总股本0.89%,本次减持计划已经实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
宁波梅山保税港区天鹰合胜创业投资合伙企业(有限合伙)	5%以下股东	3,787,854	4.58%	IPO前取得:3,787,854股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
宁波梅山保税港区天鹰合胜创业投资合伙企业(有限合伙)	738,127	0.89%	2024/12/12～2024/12/26	集中竞价交易	39.75—45.15	31,812,140.03	已完成	3,049,727	3.69%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致　　√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持　　□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划　　□是 √否

特此公告。

恒烁半导体(合肥)股份有限公司董事会
2024年12月28日

证券代码:001267　　证券简称:汇绿生态　　公告编号:2024-104

汇绿生态科技集团股份有限公司 关于全资子公司为公司担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

汇绿生态科技集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司汇绿园林建设发展有限公司(以下简称"汇绿园林")与上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行(以下简称"浦发银行宁波分行")签署《最高额保证合同》,为公司提供连带责任保证,担保最高额不超过人民币壹亿壹仟柒佰万元整。担保期限为自2024年12月26日起至2029年12月26日止。

合同签署日期:2024年12月26日

合同签署地:宁波市北仑区

公司于2024年7月11日召开第十届董事会第二十七次会议、2024年7月29日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于全资子公司对公司提供担保额度的议案》,同意公司拟通过全资子公司汇绿园林建设发展有限公司为公司向银行等金融机构申请授信额度提供担保,担保额度总计不超过人民币4亿元,额度有效期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

本次担保合同签署后的累计担保金额,尚在公司2024年第一次临时股东大会审批通过的额度内,无需提交董事会、股东大会审议。

二、担保情况明细

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	本次担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
汇绿生态科技集团股份有限公司	汇绿园林建设发展有限公司	100%	54.53%	118,000	0	0	否
汇绿园林建设发展有限公司	汇绿生态科技集团股份有限公司	担保方为汇绿生态全资子公司	38.99%	28,300	11,700	7.70%	否

注1:"担保额度占上市公司最近一期净资产比例"为本次新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例。

注2:以上数据均以2023年12月31日经审计的财务报表数据为计量基础。

三、被担保人基本情况

公司名称:汇绿生态科技集团股份有限公司

成立日期:1990年01月29日

注册地点:青年路556号(青洲盛汇)房开大厦37层

法定代表人:李晓明

注册资本:77957.1428万元

经营范围:一般项目 : 企业总部管理;园林绿化工程施工;城市绿化管理;工程管理服务;水环境污染防治服务;土壤环境污染防治服务;土壤污染治理与修复服务;树木种植经营;林业产品销售;花卉种植;货物进出口;技术进出口;光通信设备销售;光电子器件销售;金属材料销售;建筑材料销售;金属结构销售;非金属矿及制品销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);以自有资金从事投资活动。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

股权结构:汇绿园林为汇绿生态100%控股的全资子公司

财务数据:

单位:元

项目/年度	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	2,664,618,288.04	2,490,992,999.01
负债总额	1,139,756,532.18	971,359,613.81
流动负债	990,424,513.56	825,198,476.88
预计负债	78,000.00	78,000.00
净资产	1,524,861,755.86	1,519,633,385.20
其中:		
银行贷款总额	604,512,348.55	286,538,775.81
营业收入	353,185,925.24	684,835,965.52
利润总额	31,897,809.92	73,273,920.53
净利润	26,434,742.88	57,613,788.71

被担保方不是失信被执行人,经营情况稳定,不存在影响偿债能力的情况。

四、担保协议的主要内容

(一)合同各方

债权人:上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行

保证人:汇绿园林建设发展有限公司

(二)保证方式

本合同的保证方式为连带责任保证。

(三)保证期间

保证期间为,按债权人对债务人每笔债权分别计算,自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任,保证期间为各期债务履行期届满之日起,至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后三年止。

本合同所称"到期"、"届满"包括债权人宣布主债权提前到期的情形。

宣布提前到期的主债权为债权确定期间内全部或部分债权的,以其宣布的提前到期日为全部或部分债权的到期日,债权确定期间同时到期。债权人宣布包括债权人以起诉书或申请书或其他文件向有权机构提出的任何主张。

债权人与债务人就主债务履行期达成展期协议的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期届满之日后三年止。

(四) 保证范围

本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权,还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等),以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

(五)保证人承诺

(1)保证人承诺,在未经债权人书面同意之前,不采取下列行为:

A、转让(包括出售、赠与、抵债、交换等形式)、抵押、质押或以其他方式处分其重大资产的全部或大部分;

B、经营体制或产权组织形式发生重大变化,包括但不限于发生改制、股权转让、实际控制人或大股东发生变化、合并(或兼并)、分立以及减资等;

C、进行或申请进行破产、重整、解散、歇业,或被上级主管部门撤销或非正常停业;

D、签署对保证人履行本合同项下义务的能力有重大不利影响的合同/协议或承担具有这一影响的有关义务。

(2)保证人承诺,应于下列事件发生后的五(5)个银行营业日内立即通知债权人:

A、发生了有关事件导致保证人在本合同中所做的陈述与保证成为不真实、不准确的、不完整、违反法律规定或失效的;

B、保证人或其控股股东、实际控制人或其关联人、法定代表人涉及诉讼、仲裁或其资产被扣押、查封、冻结、强制执行或被采取了具有同样效力的其他措施;

C、保证人的法定代表人或其授权代理人、负责人、主要财务负责人、通讯地址、企业名称、办公场所等事项发生变更,或保证人变更住所地、经常居住地、变更工作单位、长期离开所居住城市、变更姓名或在收入水平方面发生不利变化的;

D、被其他债权人申请重整、破产或被上级主管单位撤销的。

(3)保证人承诺,在本合同的签署和履行过程中,将根据债权人的要求配合提供相应的财务资料。

(4)保证人承诺,在主合同项下当债务人未按照债权人要求补足保证金(包括提前补足)时,由保证人承担连带补足保证金的责任(该等保证金将同样作为主债权的质押担保,但无需另行签署保证金质押合同)。保证人补足保证金不免除其依据本合同所应承担的保证责任。因保证人依据本合同履行补足保证金资责任时所发生的任何损失(包括利息损失)均由保证人自行承担。

(5)保证人确认,在债权人主合同项下所有债权被全部清偿之前,保证人不得向债务人行使因承担本合同担保责任而享有的追偿权及相关权利(包括但不限于以其欠付债务人的任何债务进行抵消)。

(6)债务人提前偿还全部或部分债务或者债务人对债权人进行个别清偿的,保证人对该提前还款或个别清偿被撤销后形成的债权人对债务人的债权继续承担连带保证责任。

(7)若保证人为上市公司或上市公司的控股子公司、或者保证人的股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的,保证人承诺公开披露本合同项下的担保事项已经其董事会或者股东大会决议通过的信息。

(8)保证人确认,即使债权人放弃或变更债务人自己提供的抵押或质押担保,或改变债务人自己提供的抵押或质押担保的顺位,保证人的担保责任不予免除也不受任何影响。

(六)违约事件

有下列情况之一的,即构成保证人对债权人的违约:

(1)保证人在本合同中作出的任何陈述或保证不真实、不准确、具有误导性、已失效或已违反的。

(2)保证人违反本合同第三条任一约定事项或本同其他约定义务的。

(3)保证人停业、停产、歇业、整顿、重整、僵局、清算、被接管或托管、解散、营业执照被吊销或被注销或破产的。

(4)保证人财务状况恶化,经营出现严重困难,或发生对其正常经营、财务状况或偿债能力产生不利影响的事件或情况。

(5)保证人或其控股股东、实际控制人或其关联人、法定代表人涉及重大诉讼、仲裁或其重大资产被扣押、查封、冻结、强制执行或被采取了具有同样效力的其他措施,导致对保证人的偿债能力产生不利影响的。

(6)保证人为自然人,死亡或被宣告死亡的,或假借婚姻关系变更转移资产或者试图转移资产的。

(7)发生其他情形,依债权人合理判断可能或已经对保证人在本合同项下履约能力造成重大影响的。

(七)违约处理

如发生上款所述任一违约事件或法律规定债权人可行使本合同项下担保权利之情形,债权人有权宣布主债权及/或债权确定期间提前到期,及/或要求保证人依法承担保证责任或依据本合同约定补足保证金。

(八)生效、变更和解除

(1)本合同经保证人法定代表人或授权代理人签名(或盖章)并加盖公章、及债权人法定代表人/负责人或授权代理人签名(或盖章)并加盖公章(或合同专用章)后生效,至本合同项下被担保的债权全部清偿完毕后终止(若保证人为自然人的仅需签名;保证人为境外公司的需经保证人法定代表人或有权签字人签名(或盖章)并加盖公章(若有))。

(2)本合同任何条款的无效、被撤销或不可执行,不影响其他合同条款的有效性和可执行性。

(3)本合同生效后,合同双方任何一方不得擅自变更或提前解除本合同。如本合同需要变更或解除时,应经本合同双方协商一致,并达成书面协议。

(九)合同要素条款

(1)主合同项下债务人:汇绿生态科技集团股份有限公司

(2)被担保债权

本合同项下的被担保主债权为,债权人在自2024年12月26日至2029年12月26日止的期间内与债务人办理各类融资业务所发生的债权(前述期间是最高额担保债权的确定期间,即"债权确定期间"),以及双方约定的在先债权(如有)。前述主债权本金余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币(币种)壹亿壹仟柒佰万元整(大写)为限。

(3)双方约定的其他事项

本最高额合同签订已存在的94072024280464编号合同下的银行债权,经各方协商一致,同意转入本最高额保证担保的债权范围。

(十)其他说明

本次担保的担保人为公司100%持股的全资子公司,不涉及需要其他股东方提供担保、反担保情况。

五、董事会意见

根据公司战略发展目标和公司业务发展情况,本次担保额度,考虑为公司的正常资金需求,并能够促进公司的持续发展,符合全体股东的利益。

本次担保文件签署后,公司对外担保总额未超出2024年第一次临时股东大会审批通过的担保额度。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司累计为全资子公司担保总金额为118,000万元,担保总额占公司合并报表最近一期经审计净资产的比例为77.65%。

全资子公司为公司担保金额为11,700万元。担保额度占公司合并报表最近一期经审计净资产的比例为7.70%。

公司及控股子公司未对合并报表外的单位提供担保。公司及控股子公司未发生逾期债务,不涉及相关担保引起的诉讼风险。

七、其他需要说明的事项

本合同经保证人法定代表人或授权代理人签名(或盖章)并加盖公章、及债权人法定代表人/负责人或授权代理人签名(或盖章)并加盖公章(或合同专用章)后生效。

八、备查文件

1、第十届董事会第二十七次会议决议;

2、2024年第一次临时股东大会决议;

3、最高额保证合同。

特此公告。

汇绿生态科技集团股份有限公司
董事会
2024年12月28日

证券代码:001309　　证券简称:德明利　　公告编号:2024-118

深圳市德明利技术股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"公司")近日收到了控股股东李虎先生的通知,获悉其将所持有的公司部分股份办理了质押及解除质押手续,具体情况如下:

一、股东股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
李虎	是	7,180,000	12.29	4.83	是,首发限售股	否	2024年12月25日	至申请解除质押之日止	国泰君安证券股份有限公司	偿还债务

二、本次股东股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押起始日	解除质押日	质权人
李虎	是	3,900,000	6.68	2.62	2024年3月18日	2024年12月26日	华西证券股份有限公司

三、股东股份累计质押基本情况

截至公告披露日,李虎先生所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结、标记数量(股)	占已质押股份比例(%)	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例(%)
李虎	58,401,775	39.26	19,060,000	22,340,000	38.25	15.02	22,340,000	100	36,061,775	100

四、其他说明

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市德明利技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕1608号)核准,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票13,029,608股(以下简称"本次发行"),在本次发行中,李虎先生认购了公司1,302,960股股票。截至本公告披露日,本次发行新增股份的登记托管事宜尚在办理中,上表中李虎先生的持股情况和公司总股本均未包括本次发行的股票。

李虎先生资信情况良好,具备相应的偿还能力,还款资金来源为自筹资金等。本次股份质押亦不存在控股股东非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形,不会导致公司实际控制权或第一大股东发生变更,质押风险在可控范围内,不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响,亦不涉及业绩补偿义务。

关于李虎先生股份质押的后续情况,公司将根据相关规定要求及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、控股股东李虎先生出具的关于质押部分股份的告知函;

2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》;

3、中国证券登记结算有限责任公司出具的《持股5%以上股东每日持股变化明细》。

特此公告。

深圳市德明利技术股份有限公司董事会
2024年12月27日

证券代码:688484　　证券简称:南芯科技　　公告编号:2024-070

上海南芯半导体科技股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划完成暨减持结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 大股东的基本情况

本次减持计划实施前,上海南芯半导体科技股份有限公司(以下简称"公司")股东上海集成电路产业投资基金股份有限公司(以下简称"上海集电")持有公司股份24,778,189股,占公司总股本的 5.82%。上述股份均来源于公司首次公开发行前取得的股份,并于2024年4月8日起上市流通。

● 减持计划的实施结果情况

公司于2024年10月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2024-051),由于股东自身经营资金需要,上海集电将根据市场情况拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过 4,254,577股,拟减持股份数量占公司总股本的比例合计不超过1.00%,减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的2个月内。

公司于 2024年12月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海南芯半导体科技股份有限公司关于持股 5%以上股东权益变动至5%的提示性公告》(公告编号:2024-067),在2024年11月28日至2024年12月11日期间,上海集电通过集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份 3,505,301股,占公司总股本的比例为0.82%。

公司近日收到股东上海集电出具的股份减持结果的告知函,截至2024年12月27日收盘,上海集电通过集中竞价和大宗交易方式累计减持了公司股份4,254,577股,占公司总股本1.00%。本次减持计划已实施完毕。现将相关减持结果情况公告如下:

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
上海集电	5%以上非第一大股东	24,778,189	5.82%	IPO前取得:24,778,189股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
上海集电	4,254,577	1.00%	2024/10/30～2024/12/27	集中竞价交易、大宗交易	37.52—42.65	167,192,313.48	已完成	20,523,612	4.82%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致　　√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持　　□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划　　□是 √否

特此公告。

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会
2024年12月28日